

SF32LB52x

超低功耗大小核 Arm Cortex-M33 STAR-MC1@192MHz/24MHz, 787 CoreMark
高性能 2D/2.5D 引擎, 576KB 内存, BT/BLE 5.3

产品简介

产品特色

- 基于 Arm Cortex-M33 STAR-MC1 的创新大小核处理器架构,大核最高 192MHz,小核最高 24MHz, 787 CoreMark, 370 DMIPS, 有效兼顾高性能计算和超低功耗待机的二相场景
- ePicasso 2.0 高性能 2D/2.5D GPU, 支持实时旋转、缩放等动效, 支持最多四图层叠加
- eZip 2.0 无损压缩格式硬件解压缩, 支持原生无损压缩动画
- 双模蓝牙 5.3, EDR2 灵敏度 -95.5dBm, BLE 1Mbps 灵敏度 -100dBm, 峰值接收电流 2.4mA@3.8V
- 高保真音频 ADC/DAC, 支持音频播放与蓝牙通话
- 片上集成 576KB SRAM, 并支持各种片外存储, 包括 NOR、NAND、eMMC, 支持合封 (SiP) OPI-PSRAM
- 支持锂电池供电, 集成充电, 最大充电电流 560mA; 集成 2 路对外 3.3V 供电 LDO, 最大负载电流 150mA×2
- 采用 QFN68L 封装, 最多 45 个 GPIO, 支持各种丰富的外设

应用场景

- 智能手表、运动手环
- 可穿戴医疗器材
- 健身器材
- 图形化人机交互设备
- 中小型智能家电
- 低功耗传感器中心

SF32LB52x 是一系列用于超低功耗人工智能物联网 (AIoT) 场景下的高集成度、高性能 MCU 芯片。芯片采用了基于 Arm Cortex-M33 STAR-MC1 处理器的大小核架构, 集成高性能 2D/2.5D 图形引擎, 双模蓝牙 5.3, 以及音频 codec, 可广泛用于腕带类可穿戴电子设备、智能移动终端、智能家居等各种应用场景。

芯片中大核性能处理器最高工作频率达 192MHz, 单核性能达 787 CoreMark, 支持动态频率功耗调节, 功耗效率最高可达 4.8uA/CoreMark, 在用于提供丰富应用和流畅人机交互所需的高性能算力的同时, 还可作为 Sensor Hub 控制多种传感器以及运行蓝牙协议栈, 从而很好地兼顾流畅人机交互所需的高计算性能与长待机时间所需的超低功耗运行之间的平衡关系。

芯片内集成 2D/2.5D GPU, 主频最高达到 192MHz, 支持双图层叠加, alpha 混叠, 硬件加速的实时旋转和缩放, 以及各种常用图形格式转换。支持硬件加速无损压缩图形解压缩, 支持原生动画, 可以大幅提高带宽利用率, 降低存储成本。芯片内置 LCD 控制器, 支持 8080/QSPI 等多种接口, 可不依赖于 CPU 自主实现最高 60fps 的全屏刷新帧率, 并支持低功耗息屏常显。

集成世界水平的双模蓝牙 5.3 收发机, 经典蓝牙 EDR2 模式最高发射功率 13dBm, 接收峰值功耗低至 2.4mA@3.8V, 低功耗蓝牙接收灵敏度达到 -100dBm (1Mbps), 经典蓝牙 EDR2 模式灵敏度 -95.5dBm。集成高保真音频 ADC 和 DAC, 支持蓝牙通话和连接耳机 MP3 播放。



CPU 与内存

- 性能处理器/大核 (HCPU)
 - 处理器: Arm Cortex-M33 STAR-MC1
 - 主频: 最高 192MHz, 可调节
 - 单核最高 296 DMIPS, 787 EEMBC CoreMark
 - I-Cache + D-Cache: 32KB(2-way)+16KB(4-way)
 - SRAM: 512KB (全部为 Retention SRAM)
 - CoreMark 功耗效率: 低至 23uA/MHz @3.8V
 - 单精度浮点运算单元 (FPU)
 - 内存保护单元 (MPU)
- 超低功耗处理器/小核 (LCPU)
 - 处理器: Arm Cortex-M33 STAR-MC1
 - 主频: 最高 24MHz, 可调节
 - SRAM: 64KB (全部为 Retention SRAM)

无线连接

- 双模蓝牙 5.3, 支持 BLE Audio
- 灵敏度: -100dBm (BLE/1Mbps), -96.3dBm (BR), -95.5dBm (EDR2)
- 最大发射功率: 13dBm (EDR2/3), 19dBm (BR/BLE)
- 接收机峰值功耗 (BR): 2.4mA@3.8V

音频

- 1× 高保真 24-bit 音频 DAC, 109dB SNR
- 1× 高保真 24-bit 音频 ADC, 99dB SNR

图形显示

- 2D/2.5D 图形引擎—ePicasso™2.0
 - 支持硬件加速的旋转、缩放和镜像
 - 最大解析度 512×512
 - 支持 aRGB8565, aRGB8888, L8, A8/4/2, YUV, 支持 alpha 混叠
- 无损解压缩加速器—eZip™2.0
 - 硬件无损图形解压缩
 - 支持 eZip-A 原生无损动画
 - 支持与 ePicasso™2.0 联动, 无须中间缓存
- LCD 控制器
 - 支持 8080, SPI, Dual-SPI, Quad-SPI
 - 支持单图层与纯色背景图层的 alpha 混叠
 - 独立 LCD 控制器, 支持息屏常显模式

存储接口

- 支持合封 (SiP) OPI-PSRAM, 接口最高频率 144MHz
- 1×MPI(QSPI), 支持 NOR、NAND、QPI-PSRAM
- 1×SD/SDIO, 支持 SD3.0, SDIO3.0, eMMC

其它

- DMA
 - 通用 DMA: 用于与外设间高效率数据搬运
 - extDMA: 用于与外部存储间高效率数据搬运
- 安全
 - AES 加速器
 - HASH 加速器
 - CRC 加速器
 - 真随机数发生器 (TRNG)
 - PSA Certified Level 1 认证
- 定时器
 - 2×16b GPTIM, 2×32b BTIM, 1×32b ATIM
 - 2×24b LPTIM
 - 1×RTC
 - 2×看门狗 24b WDT, 1×独立看门狗 IWDT
- 模拟
 - 1×12-bit 通用 SAR ADC, 共 8 通道
 - 1×片上温度传感器
- 连接外设
 - 最多 45 个 GPIO
 - 3×UART, 4×I²C, 2×SPI
 - 1×I²S, 1×PDM
 - 1×USB2.0 FS
 - 外设任务控制器 (PTC)
- 电源管理
 - 内置高效率 Buck 及低功耗 LDO
 - 提供两路对外 3.3V 供电, 最大电流 150mA×2
 - 休眠功耗: 2uA
 - 内置 560mA 锂电池线性充电器, 支持 4.2V-4.45V 满电电压
 - VBAT 电压范围: 3.2V-4.7V
 - VBUS 电压范围: 4.6V-5.5V

封装

- QFN68L, 45 个 GPIO, 7mm×7mm×0.85mm